**证券代码：688535 证券简称：华海诚科**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 √业绩说明会□新闻发布会 □路演活动√现场参观 □电话会议□其他 （请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 华西证券、华安证券、线上业绩说明会 |
| **会议时间** | 2023年 10月 23日10：00-11：00 |
| **会议地点** | 现场；线上 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长、总经理韩江龙董事会秘书：董东峰证券事务代表：钱云证券事务专员：张雅婷 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 问题一：EMG-900-ACF（GMC 颗粒状塑封料）目前有哪些客户在验证中？客户A年底有批量吗？预计量多大？回复：重庆矽磐微、合肥矽迈、中科芯、通富微电等客户处于验证中；客户A的使用量前期预计不会很大，后期会逐步提升，具体量暂时未知。问题二：68 系列（液态塑封料 LMC）在通富微电、华进半导体的验证结果是什么？是否已经有客户在量产中使用？EMG-900-ACF（GMC 颗粒状塑封料）目前进度如何？是否有客户在量产中使用？与客户A的合作，目前阶段有哪些序列产品出货？回复： 68系列在通富微电，模塑性验证合格，正在其他客户处进行可靠性考核；900系列产品客户仍处于持续验证过程中，目前暂未量产；与客户A的合作，目前仍处于验证过程中，预计今年年底会有批量。问题三：公司在先进封装领域积极配合华为等业内新概念厂商开展研发工作，目前部分产品已陆续通过考核验证。请问，针对的是哪些产品？HBM和GPU、CPU吗？回复：公司在先进封装领域持续加大研发投入（如GMC、LMC、FC底填胶、高导热、耐高电压材料等），具体情况请见公司招股书及半年度报告。公司会根据实际情况及时披露。问题四：消费电子随着华为的复苏呈现出向好趋势，请问公司有主要保密客户追加订单吗？回复：公司一、二季度环比出货有所改善，具体情况请参考公司半年度报告。问题五：三星和SK海力士获准向华提供半导体设备，请问这是否将导致公司存储芯片封装材料订单供不应求？回复：公司的主要客户是国内的封测厂家。公司会根据下游客户的订单进行排产，具体经营情况会在定期报告是及时披露。问题六：华为和中芯国际是公司主要股东吗？回复：深圳哈勃和聚源信诚是公司上市前的原始股东。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2023年10月 23日 |